



# 新的鍍层和电解液

〔苏联〕 H·B·柯洛文 著

于 春 江 岩 譯



中国工业出版社

本书探讨了电镀技术发展中的一些新方向，介绍了一些新镀层、电解液和得到镀层的方法。本书取材于苏联及其他国家的文献以及实际工作经验。

本书适于从事金属防腐专业的工厂技术人员、科学研究人员和高等学校师生阅读。

П. В. Коровин

НОВЫЕ ПОКРЫТИЯ И ЭЛЕКТРОЛИТЫ

В ГАЛЬВАНОТЕХНИКЕ

МЕТАЛЛУРГИЗДАТ

Москва 1962

\* \* \*

### 新的 镀 层 和 电 解 液

于 春 江 岩 譯

\*

冶金工业部科学技术情报产品标准研究所书刊编辑室编辑 (北京灯市口71号)

中国工业出版社出版 (北京东城区东四10号)

北京市书刊出版业营业登记证字第110号

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

\*

开本787×1092<sup>1</sup>/<sub>32</sub>·印张4<sup>1</sup>/<sub>16</sub>·字数94,000

1965年7月北京第一版·1965年7月北京第一次印刷

印数0001—6,100·定价(科四) 0.40元

\*

统一书号: 15165·3799 (冶金-601)

# 目 录

## 原 序

第一章 新的电解液 .....	1
硼氟酸溶液.....	1
焦磷酸电解液.....	7
胺类及銨盐电解液.....	11
新的镀鉻电解液.....	15
镀錫的卤化物电解液.....	20
第二章 光亮镀层的取得 .....	22
镀鎳.....	28
镀銅.....	31
镀銀.....	33
镀鋅.....	34
镀鎘.....	35
镀錫.....	36
第三章 电积合金 .....	38
防护-装饰性镀层 .....	50
耐磨和抗磨镀层.....	62
接触点的电镀.....	73
磁性镀层.....	75
电积鎢、鉬及鉿的合金.....	77
第四章 新镀层的取得 .....	83
锰镀层的取得.....	87
鉻镀层的取得.....	88
沉积砷.....	89
电镀錫.....	89

# VI

銻鍍層的取得.....	92
電積鎗.....	93
電積鈦.....	94
電積鎘.....	98
鍍銻.....	98
電積鉭.....	100
<b>第五章 从非水溶液中取得金屬鍍層 .....</b>	<b>102</b>
鍍鋁.....	105
電積鎂.....	108
電積鎢及其合金.....	109
電積鎗.....	110
電積鎔及其合金.....	110
<b>第六章 从熔融鹽中取得鍍層.....</b>	<b>112</b>
鍍鈦.....	113
鍍鎔.....	113
鍍鎢及鉬.....	114
鍍鎇.....	115
鍍鉭.....	115
<b>第七章 取得金屬鍍層的化學方法 .....</b>	<b>116</b>
化學鍍鎳.....	116
化學鍍鈷.....	128
鐵及其合金的化學沉積.....	129
化學鍍鎔.....	129
鍍釩合金.....	130
鈀的化學沉積.....	131
化學鍍銅.....	132
化學鍍錫.....	133
金屬的接觸沉積.....	133
<b>參考文獻 .....</b>	<b>136</b>

# 第一章 新的电解液

直到最近为止，在电镀技术中主要采用硫酸和氯化物电解液，这些电解液所固有的主要缺点是，硫酸溶液均布能力①低，而且为了获得紧密和细晶镀层必须加入专门的添加剂；氯化物溶液有毒，也不够稳定。

为了提高金属沉积的速度，取代有毒溶液，取得具有特殊性能的镀层，进行过大量的研究工作，主要是探求新的电解液的方向。最近已经研究出一些新的电解液，在这些电解液中，金属的沉积速度比在硫酸溶液中可以快数十倍。取代氯化物溶液的课题看来比较困难，虽然已经研究出一些替代氯化物溶液的电解液，但是它们并不十分完善，它们有均布能力差、稳定性低、不能保证镀层和基体的牢固结合等缺点。

新研究出的电解液中最有意义且已找到实际应用的电解液有硼氟酸溶液，焦磷酸溶液，以及胺类溶液；在这些溶液中可以沉积很多金属及合金。除此而外，在工业上还使用着新的镀铬和镀锡溶液。

## 硼氟酸溶液

硼氟酸  $HBF_4$  是强酸。在水溶液中，除  $HBF_4$  外，还含有  $HBF_3OH$ ——羟基硼氟酸<sup>[10]</sup>。硼氟酸与大多数经常用作镀层的金属形成易溶盐，从硼氟酸溶液中可以得到镍、钴、

① 亦称分散能力，布散能力——译注。

鉄、銅、鋅、鎘、銻、錫及它們的合金的鍍层。

生产能力高、成份稳定而简单是硼氟酸溶液的主要优点。在这些电解液中可以得到細晶鍍层，而且当阴极电流密度比在硫酸溶液中大1—9倍时，阳极和阴极电流效率接近100%。

硼氟酸溶液非常稳定，成份简单，不需要特殊添加剂来改善溶液的导电性和緩冲性能。在硼氟酸溶液中所得鍍层比在其他电解液中得到的鍍层硬度高，塑性好和內应力小。从硼氟酸溶液中得到的鎳鍍层的显微硬度为300—550公斤/毫米<sup>2</sup>，而在相同条件从硫酸电解液中所得鍍层的显微硬度为200—250公斤/毫米<sup>2</sup>[11, 12]。当用阴极弯曲法測定內应力时，在相同条件下，于硼氟酸溶液中弯曲度为3.0—3.5毫米，而在硫酸电解液中为5.5—7.0毫米。

从沒有添加剂的硫酸溶液中得到的鐵鍍层的显微硬度为290公斤/毫米<sup>2</sup>，而在硼氟酸电解液中則为520公斤/毫米<sup>2</sup>[13, 14]。

硼氟酸电解液的特点是，硼氟酸盐的溶解度大，导电性高以及緩冲性能好。在室溫下可以制备7N的銅溶液、6N的鎳溶液和5N的鈷溶液。在浓溶液中形成絡合物可能是硼氟酸盐溶解度大的原因之一。吸收光譜的研究表明[15]，当鎳或鈷的硼氟酸浓度等于或大于2克-当量/升时，能形成不牢固的自絡合型的絡合物。由于盐的溶解大，在硼氟酸溶液中阳极过程沒有任何复杂性，在高浓度溶液中，沉积金属可以在比較高的电流密度下实现。

鎳和鈷的硼氟酸溶液的比电导比硫酸溶液大1倍[12, 16]，当电流密度为5安培/分米<sup>2</sup>、溫度为40°C时，在硼氟酸溶液中鍍鎳的槽压为1.73伏，而在硫酸溶液中則为2.32伏[11]。

在寬广的 pH 范圍內硼氟酸电解液比硫酸溶液具有較好的緩冲性能（图 1），这是由于硼氟酸溶液中存在有几种酸（硼氟酸，一羟基硼氟酸，硼酸）以及它們的盐类和其他化合物。当溶液中加入碱时，发生下面的反应： $\text{BF}_4^- + \text{OH}^- \rightarrow \text{BF}_3\text{OH}^- + \text{F}^-$ 。当溶液中加入  $\text{H}^+$  离子时，发生相反的反应，也可能有下面的过程：



由于溶液的緩冲性能好，因此阴极附近薄层中的 pH 值在电解过程中变化很小，这对电积层的质量有有利的影响。硼氟酸盐的水解比硫酸盐和氯化物盐类小，因此在阴极附近的电解液中形成金属氢氧化物的可能性減少了。这有助于使用較高的电流密度和改善鍍层的质量。

硼氟酸通常由氢氟酸和硼酸来制备[11, 12, 17]。制备硼氟酸盐最常用方法是在硼氟酸中加入相应的金属碳酸盐。

目前硼氟酸电解液比硫酸溶液貴，因此，比較合理的是用于下列一些場合：需要加速金属的沉积过程；在电鑄中为了得到厚度大和塑性好的沉积层；鍍金属綫和帶；修补磨损的零件；用电解法制造金属带、管子和双金属。

由于硼氟酸溶液的均布能力差，因而不能用于覆盖几何形状复杂的制品。

**镀铜** 在镀铜的硼氟酸溶液中允許的电流密度随銅浓度增加和溫度升高而加大。例如，当銅浓度是 17 克/升和溫度 20°C 时，电流密度为 2 安培/分米<sup>2</sup>，而在銅含量为 80 克/升和溫度 65°C 时，电流密度可达 65 安培/分米<sup>2</sup>[18]。在硼氟酸溶液中沉积出的鍍层結晶細而光洁，容易抛光。电解液对盐的浓度、溫度和电流密度的变化不敏感，但是如在硫酸溶液中一样，在硼氟酸溶液中不能直接在銅上鍍銅，也不能鍍

形状复杂的零件。

硼氟酸溶液镀铜适用于电铸，制造双金属，铜带以及其他需要得到大厚度镀层的场合。溶液成份和沉积条件如下[19]：

$\text{Cu}(\text{BF}_4)_2$ , 克/升	224	336
$\text{Cu}$ , 克/升	60	90
$\text{HBF}_4$ 游离, 克/升	2	2
pH	0.8—1.4	0.2—0.8
温度, $^{\circ}\text{C}$	25—75	25—75
电流密度, 安培/分米 <sup>2</sup>	8—14	15—30

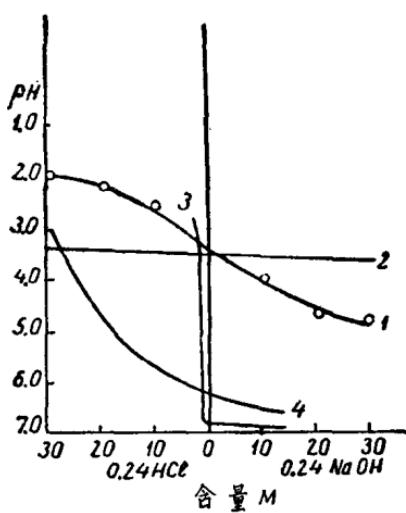


图 1 硼氟酸镍和硫酸镍电解液的缓冲性能[12]：

1—1-N 硼氟酸电解液；2—3-N 硼氟酸电解液；3—N 无添加剂的硫酸电解液；4—含 0.5-N 硼酸和 0.2-N 氟化钠的硫酸电解液

**镀锌** 用于镀金属丝、带、板材以及在滚筒和钟形槽内滚镀小零件。镀锌用的硼氟酸溶液成份列于表 1。

**镀鎘** 硼氟酸溶液被推荐（表 2）在滚筒和钟形槽内镀紧固零件以及在不希望被镀表面有渗氢时应用。

**镀镍** 关于在硼氟酸溶液中镀镍已有大量著作[11, 12, 22—26]发表。

曾经确定，镀镍最好在含镍 3.0 和 3.5 N、游离硼酸量不大（10—30 克/升）和 pH 为 2.8—3.5 的溶液中进行。添加镍的氯化物（10—15 克/升）对阳极和阴极过程均有良好影响。在硼氟酸

（10—15 克/升）对阳极和阴极过程均有良好影响。在硼氟酸

沉积锌的硼氟酸溶液成份和沉积条件

表 1

电解液組份(克/升)和 沉积条件	普通槽	普通槽	高速槽
	[20]	[19]	[19]
Zn(BF <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>	180	200	300
NH <sub>4</sub> BF <sub>4</sub>	30	35	35
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	25	—	—
NH <sub>4</sub> Cl	—	54	27
β-荼酚	1.0	—	—
甘草根浸出物	—	1	1
pH	5.0—5.4	—	3.5—4.0
电流密度, 安培/分米 <sup>2</sup>	4.5—10	—	2.7—90
溫度, °C	25	—	27—55

鍍銻溶液的成份和条件

表 2

电解液組份(克/升) 和沉积条件	文 献 来 源	
	[19]	[21]
Cd(BF <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>	240	210
NH <sub>4</sub> BF <sub>4</sub>	60	40
甘草根浸出物	1	—
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	—	25
β-荼磺酸鈉	—	1.0
pH	4.0—4.6	3.5—4.0
溫度, °C	25—35	20—30
电流密度, 安培/分米 <sup>2</sup>	3.0—6.5	2.2—6.5

溶液中鍍鎳的最大和迄今未能完全克服的困难是在鍍层上有麻点形成。为消除麻点有人推荐添加湿润剂, 例如, 添加0.2—0.3毫升/升ОП-7[11]。每通过100安培·小时/升的电量后添加2—3毫升/升含0.1克/升ОП-7的溶液。В.И.拉伊聶尔和 И.И.潘欽柯为了减少麻点曾推荐在搅拌下用电流密度为0.3—0.5安培/分米<sup>2</sup>的电流处理电解液的方法。

鍍鎳的电解液成份列于表 3 中。

沉积鎳的溶液成份和条件

表 3

电解液組份 (克/升) 和沉积条件	文 献 来 源	
	[12]	[19]
Ni	80—100	70—110
HBF <sub>4</sub> 游離	—	4—40
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	10	30
NiCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	15	—
pH	3.0—3.5	2.7—3.5
溫度, °C	50	30—50
电流密度, 安培/分米 <sup>2</sup>	20.0以下	2.5—17.0

**鍍鐵** 在硼氟酸溶液中可沉积出細晶粒的塑性鍍层，显微硬度为 400—600 公斤/毫米<sup>2</sup>。电解液对氧化是稳定的，在 pH=3—4 的范围内具有良好的緩冲性能。于这些溶液中可以在比較低的溫度和比較高的电流密度下电鍍。硼氟酸鍍鐵溶液被推荐用于修复磨損零件。电积鐵的条件和溶液成份制訂如下[14]：300 克/升 Fe(BF<sub>4</sub>)<sub>2</sub>；18 克/升 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>；1—2 克/升 HBF<sub>4</sub>游離；pH=3.2—3.6；溫度 20—60°C；阴极电流密度 2—12 安培/分米<sup>2</sup>。在电解液有攪拌的情况下电流密度可提高 0.2—0.5 倍。

**鍍鈷** 为了避免得到质量不好的鍍层，从硼氟酸溶液中沉积鈷不宜采用浓溶液（不超过 2 克-当量/升 Co），而且电解液不能加热[16, 27]。可以在含 233 克/升 Co(BF<sub>4</sub>)<sub>2</sub> 的电解液中，在 pH=3—4、溫度 20—25°C 和电流密度 5—6 安培/分米<sup>2</sup>的情况下得到鈷的鍍层。

**鍍錫** 与硫酸溶液相比在硼氟酸溶液中可以得到比較光洁和細晶的錫鍍层，这些鍍层还比較容易焊接。阴阳极电流

效率接近 100%。这些电解液推荐用于薄钢板和金属丝的镀锡（表 4）。

硼氟酸电解液的特点也有其他强络合酸盐电解液，如硅氟酸、钛氟酸、氯酸等电解液的特性。因此，这些电解液可以在强化覆盖过程方面找到应用，例如，在 3M 的钛氟酸铜的溶液中，在温度 50°C、有搅拌、电流密度 30—60 安培/分米<sup>2</sup>的条件下曾镀得厚而光滑的铜镀层<sup>[31]</sup>。

鎳錫的溶液成份和条件

表 4

电解液组份(克/升) 和沉积条件	静止槽 [19]	金属丝 镀槽 [30]
Sn(BF <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>	200	200—300
HBF <sub>4</sub> 游離	50	200
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> 游離	25	—
骨胶	6	—
β—萘酚	1	0.5
动物胶	—	3.0
丹宁萃	—	0.5
pH	0.2	—
温度, °C	20—38	室温
电流密度, 安培/分米 <sup>2</sup>	2.8—14	60—140

### 焦磷酸电解液

焦磷酸盐能与铜、镍、钴、锌、镉、铅、锡、铊及其他金属形成络合物。已经确定有两种型式的络合离子存在：



如所周知，络合离子的热力学稳定性由不稳定常数决定：

$$K = \frac{[M^{z+}]^x [A^{n-}]^y}{[M_x A_y]},$$

式中  $(M^{z+})$  ——金属离子的浓度；

$(A^{n-})$  ——络合剂的浓度；

$(M_z A_v)$  ——络合离子的浓度。

根据不稳定常数可以判断在络合物溶液中金属的平衡电位。

不稳定常数愈小，溶液中金属离子的浓度愈低（当络合剂浓度相等时）金属在该溶液中的平衡电位值的负值愈大。

从表 5 可见，焦磷酸盐的络合阴离子并不很牢固，但因为金属在这些电解液中沉积时有很高的化学极化，所以在焦磷酸溶液中进行沉积过程的电位值的负值比在硫酸和氯化物溶液中要大得多。例如，在含铜 0.175N 的焦磷酸铜溶液中沉积铜的电位负值在某些情况下比在硫酸溶液中大 1 伏特。

焦磷酸络合离子的不稳定常数[32]

表 5

络合离子	Cu	Ni	Zn	Cd	Pb	Tl
$[Me_n P_2O_7]^{(4-n)-}$	$2 \times 10^{-7}$	$1.5 \times 10^{-6}$	—	$2.7 \times 10^{-6}$	—	$2.0 \times 10^{-2}$
$[Me_n (P_2O_7)]_2^{(8-n)-}$	$1.0 \times 10^{-9}$	$6.5 \times 10^{-8}$	$3.4 \times 10^{-7}$	—	$4.74 \times 10^{-2}$	$1.35 \times 10^{-2}$

为了取代氯化物溶液，从焦磷酸溶液中电积金属的研究工作已经进行很久，但是对这些电解液比较详细的研究和在实际上应用它们还只是从 1940 年才开始[35—39]。

从焦磷酸电解液中取得镀层为下列一些困难所障碍：焦磷酸络合物在水中的溶解度不大；阳极要钝化；在温度高时焦磷酸盐要分解。用钾盐代钠盐可提高焦磷酸盐的溶解度和在比较高的电流密度下得到质量好的镀层。

为了防止阳极钝化，在电解液内添加氨、铵盐、草酸盐、柠檬酸盐、酒石酸盐、磷酸氢二钠及其他化合物。目前

已研究出鍍銅、鋅、錫、鉛、鎳及它們的合金的焦磷酸电解液<sup>[41]</sup>。

焦磷酸溶液操作上的困难限制了它們只能用于取代鍍鋅、鍍銅的氰化物电解液和电积合金。用焦磷酸电解液鍍錫、鉛、鎳和其他金属未必有实际意义，因为它們与目前采用的鍍錫电解液（硫酸和錫酸盐溶液）、鍍鉛电解液（硼氟酸和碱性溶液）和鍍鎳电解液相比并无太多优点。

**鍍銅** 从焦磷酸溶液中鍍銅在苏联已为很多科学工作者研究过<sup>[34, 35, 42, 45]</sup>。在表 6 中列有不同作者所推荐的电积銅的电解液成份和工作条件。

鍍銅的焦磷酸电解液

表 6

电解液成份 (克/升) 和沉积条件	[35]	[42]	[36]	[41, 48]
CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O	35	50	—	—
Cu	—	—	22—38	31.8
Na <sub>4</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub> ·10H <sub>2</sub> O	140	200	—	—
K <sub>4</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub> ·3H <sub>2</sub> O	—	—	150—200	190.8(P <sub>2</sub> O <sub>7</sub> )
Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> ·12H <sub>2</sub> O	95	75—95	—	—
酒石酸鉀銨	25	—	—	—
氨	—	—	1—3	—
草酸根离子	—	—	15—30	—
硝酸根离子	—	—	5—10	—
檸檬酸鉀	—	—	—	20
pH	9—10	7—9	8.2—8.8	8.1
溫度, °C	25—35	35—40	50—60	60
阴极电流密度, 安培/分米 <sup>2</sup>	0.5—0.75	0.5—0.8	1.1—8.8①	2.0到10①

① 有攪拌时。

焦磷酸电解液的缺点是稳定性差和銅与鋼的结合力不是任何时候都很好。为了改善鍍层和鋼的结合力，推荐将被鍍

零件在接通电流的情况下以較高的起始电流密度挂入鍍槽，此时在加有檸檬酸盐或草酸盐的焦磷酸鉀溶液中可以获得可靠的結果[36, 41, 44]。在某些工厂中在焦磷酸电解液中直接在鋁及鋁合金上鍍銅。結合牢固、紧密而无孔的銅鍍层可在下列成份的电解液中得到(克/升)： $30-35 \text{ CuSO}_4 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$ ； $120-145 \text{ Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}$ ；或  $100-125 \text{ K}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 3 \text{ H}_2\text{O}$ ； $60-100 \text{ Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12 \text{ H}_2\text{O}$ ； $\text{pH} = 7.5-8.0$ ；溫度  $50-70^\circ\text{C}$ ；电流密度  $1.2-1.7$  安培/分米 $^2$ ，用空气攪拌电解液。銅的电流效率为  $92\%$ [45]。

**鍍鋅** 在焦磷酸溶液中曾得到过光亮、細晶和在阴极表面均匀分布的鋅鍍层[46, 47]。J.I.A. 別里雅柯娃制訂的电解液成份如下(克/升)： $34 \text{ ZnSO}_4 \cdot 7 \text{ H}_2\text{O}$ ； $137 \text{ Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}$ ； $84 \text{ Na}_2\text{HPO}_4$ ； $\text{pH} = 9.0$ ；沉积在溫度  $35-40^\circ\text{C}$  和电流密度  $0.5-1.5$  安培/分米 $^2$ 下进行。

現在已知有添加醋酸銨和糊精的比較浓的电解液。

也有人介紹下列成份的含檸檬酸盐及鉬酸的焦磷酸溶液

鍍錫、鍍鎳及鍍鉛的焦磷酸电解液

表 7

电解液成分(克/升) 和沉积条件	鍍层		
	錫	鎳	鉛
被沉积的金属	32.4	29.4	20.7
$\text{P}_2\text{O}_7$	164.2(Na)	234.8(K)	79.2(Na)
添加剂	10糊精； 1动物胶	33.3檸檬酸 銨	1胶
pH	9.0	9.5	9.8
温度, $^\circ\text{C}$	60—80	60	50
最大阴极电流密度, 安培/分米 $^2$ ①	5.0	6.0	5.0
阴极电流效率, %	91—100	86—93	97—100

① 溶液建議攪拌。

(克/升): 21.7Zn; 169.9P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>; 15 檸檬酸銨; 5 鉬酸; pH=8.5; 电鍍在溫度 55°C 和电流密度 4.5 安培/分米<sup>2</sup> 的条件下进行<sup>[41, 47]</sup>。

拉馬恰爾研究了从焦磷酸溶液中电积錫、鎳、鉛及其他金属。

他所建議的溶液成份和沉积条件列于表 7 中<sup>[40, 41]</sup>。

### 胺类及銨盐电解液

氨和很多金属形成牢固的絡合物<sup>[32]</sup>。

鍍銅<sup>[49, 50]</sup> 和鍍鋅<sup>[51, 52]</sup> 的氨电解液曾經被詳細研究过。已經确定, 从这些电解液中可以得到細晶和分布均匀的鍍层。但是由于氨的揮发性使氨电解液不稳定, 因而这些电解液未必能找到广泛的实际应用。

采用微酸性或中性介质中的銨盐及胺类电解液比較有前途。胺类比氨稳定, 而且和很多金属形成牢固的絡合物。

**銨盐电解液** 在微酸性或中性介质中銨离子能和鋅、銅及其他金属形成 $[Zn(NH_3)_2(H_2O)_n]^{2+}$ 型式的絡合阴离子。在含有 NH<sub>4</sub>Cl 的溶液中, 鋅沉积时有很大的阴极化現象<sup>[54, 53]</sup>。在銨盐电解液中能以很高的电流效率沉积出細晶有光泽的鋅鍍层。銨盐电解液的均布能力接近氰化物溶液(表 8)。

銨盐电解液只在中性和酸性介质中稳定。溶液最佳 pH 值等于 5.5—6.5。

推荐<sup>[55]</sup>下列成分的电解液作鍍鋅之用(克/升):

1) 30—35ZnO; 200NH<sub>4</sub>Cl; 40—50NH<sub>4</sub>CNS; 1 木工胶;

2) 14ZnO; 250NH<sub>4</sub>Cl; 20H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>; 2 硫脲; 1 木工胶。

不同鍍鋅電解液的均布能力[54]

表 8

电 解 液 克/升	均布能力 %
酸性溶液 $200\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ; $100\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ; $30\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ ; 10糊精	0
氨电解液 [51]	+ 6
氯化物电解液 $45\text{ZnO}$ ; $15\text{NaOH}$ ; $75\text{NaCN}$	+25
銨盐电解液 $60-65\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ; $150\text{NH}_4\text{Cl}$ ; $20\text{H}_3\text{BO}_3$ ; 20—25NH <sub>3</sub> ; 2动物胶	+20

在溫度 20—40°C 和电流密度 1.5—2 安培/分米<sup>2</sup> (第一类溶液) 和 0.7—1.5 安培/分米<sup>2</sup> (第二类溶液) 的条件下, 能沉积出細晶鍍层, 阴阳极电流效率接近 100%。这些电解液具有接近氯化物溶液的均布能力, 而且比碱性溶液要稳定得多。

E.G. 特魯茨[56] 介绍过类似成分的溶液。

B.A. 普林建議采用以硫酸鋅和氯化銨为基的电解液:  
50—100 克/升  $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ; 150—200 克/升  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ; 0.5—1 克/升动物胶; pH=5.5—6。沉积在室溫和电流密度 0.5—1 安培/分米<sup>2</sup> 的条件下进行。

銨盐电解液用于靜止槽和轉鼓槽中。銨盐电解液的优点是无毒, 均布能力高, 稳定, 成分简单。但是与氯化物溶液相比, 在銨盐电解液中沉积出的鍍层結晶粗些。

銨盐电解液也被推荐用于鍍的电积[53]。溶液成分 (克/升):  $40\text{CdO}$ ;  $250(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ; 5 糊精; 3 硫脲; pH=6.3—3.0。紧密的細晶鍍层可以在溫度 20—40°C 和电流密度 1.5—2.0 安培/分米<sup>2</sup> 的条件下取得。均布能力比硫酸和硼氟酸溶液高。

**乙二胺电解液** 乙二胺  $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$  (*En*) 和一系列